66063

アンジュレータ STM ビームラインを用いた 水素終端 Si(111)表面からの水素脱離観察

野々垣陽一 分子科学研究所,総合研究大学院大学 〒444-8585 岡崎市明大寺町西郷中38 **宇理須恒雄** 分子科学研究所,総合研究大学院大学 〒444-8585 岡崎市明大寺町西郷中38

要 旨 分子科学研究所 UVSOR BL7U にアンジュレータ STM ビームラインを建設し,水素終端 Si(111)面へのアン ジュレータ光照射実験を行った。アンジュレータ光照射後の STM 観察の結果から,アンジュレータ光照射量の増加に伴 い水素脱離を示唆する明点密度が増加することが分かった。アンジュレータギャップを変化させ水素終端 Si(111)表面へ の照射を行い, Si-H 結合の解離機構を考察した。

1. はじめに

半導体デバイス作製における微細化技術は着実に進歩し 続けており、リソグラフに用いられる光源波長は年々短波 長化されている。現在,極端紫外光を光源とする露光装置 を含むデバイス試作ラインの導入が始まっており,極端紫 外光と半導体表面との相互作用は科学的また技術的に重要 なテーマになると考えられる。

極端紫外光と半導体表面との大きなかかわり合いの一つ として、極端紫外光を用いた半導体加工プロセスの研究が ある。その1つである放射光照射を用いたエッチングは 1987年に PF と UVSOR において初めて実現された^{1,2)}。 PF では偏向電磁石から生じた放射光を SF₆ 雰囲気下で SiO₂ 表面に照射する実験が行われており、光照射部にお いて SiO₂ のエッチングが起こることが示された。また、 SiH₄ + N₂ 雰囲気では放射光照射部に Si_xN_yH₂ 膜の堆積が 起こり、放射光照射を用いた半導体プロセスの基本が示さ れた¹⁾。一方、UVSOR では N. Hayasaka 等により Cl₂ 雰 囲気下で多結晶 Si に放射光照射後に、エッチングが生じ ることを報告している²⁾。このような放射光照射を用いた 半導体プロセスは低温・高空間分解能・低損傷であると考 えられ、デバイスの微細化が進むにつれて重要になると考 えられる。

上記の SiO₂ 放射光エッチングに関して現在までに多く の報告例³⁻⁶⁾があるが、その脱離機構の詳細な研究は未だ に行われていない。それは偏向電磁石と斜入射分光器の組 み合わせでは充分なフォトンフラックスを得ることが困難 なため、脱離機構解明に必要なエッチング特性の照射光エ ネルギー依存性が得られないからである。放射光照射プロ セスでは長年この照射光エネルギー依存性を得ることが重 要な課題となっている。 本研究では照射光源としてアンジュレータ光を用い,脱 離検出に STM 観察を用いることにより,照射光エネル ギー依存性を得ることを試みた。放射光プロセスの STM 観察は T. Miyamae 等によって始められたが⁶⁾,中性脱離 種を含む全脱離反応を観察でき,また,測定が原子像で得 られるため非常に感度が高いと考えられる。また,観察範 囲が狭いため照射光を集光することによりフラックス密度 を増加することができる。アンジュレータ光は輝度が高 く,集光が容易であり,分光器なしで準単色光が得られる 特性がある。

我々は上記のアンジュレータ STM ビームラインを設計 ・建設し、水素吸着 Si(111)表面からの水素脱離について 研究を行った。水素吸着 Si表面は表面科学の基礎的問題 として、また、半導体素子作製の観点からも重要な系であ り、光刺激による水素−Si 結合の解離機構を理解すること は大きな意味がある。H−Si表面上の光刺激水素脱離に関 する報告例は多いものの脱離イオン観測がほとんどであ り^{7,8)}、中性脱離種に着目した表面反応の研究はきわめて 少なく⁹⁾、STM 観察により脱離後の表面を解析すること の意義は大きいと考えられる。

本稿では、まず、設計・建設を行った UVSOR BL7U およびエンドステーションの UHV-STM について述べた 後、初期表面として用いた水素終端 Si(111)表面およびそ の表面へのアンジュレータ照射効果について述べる。

2. 実験装置

2.1 UVSOR BL7U

放射光を利用した表面光化学反応の観察には約10^{18-10²⁰} cm⁻² 程度の高いフォトンフラックスが必要であると 考えており、それを実現するためには通常の偏向電磁石と



Fig. 1 Calculated spectra of the undulator radiation with the ring current of 200 mA for undulator gap heights of 17 mm, 20 mm and 25 mm.

斜入射分光器との組み合わせでは非常に困難である。当研 究室では1999年に偏向電磁石から生じる放射光と多層膜 分光器を用いたビームラインを建設し、3mm×3mmの 照射面積にわたり10¹⁴ cm⁻²sec⁻¹フォトンフラックスを 得ている¹⁰⁾。今回、アンジュレータの使用によりさらに 高いフォトンフラックスを目指した。

建設したビームラインは分子科学研究所極端紫外光実験施設 UVSOR BL7U¹¹⁾であり、光源として真空封止型アンジュレータを備えている¹²⁾。アンジュレータは周期長36 mm、周期数24であり、ギャップ間隔を15 mm から40 mm まで変化させることができる。その際アンジュレータの一次光は約50 eV から約120 eV まで変化し、Siの2p内殻電子励起(~100 eV)とエッチング現象などの関連を調べるのに適した光源となっている。Fig.1に、リング電流200 mA、アンジュレータギャップ17 mm、20 mm、25 mm とした場合の光源スペクトルを示す。アンジュレータ光の発散角は500 µrad 以下とした。

ビームラインの光学素子の概略図を Fig. 2 に、チャンバ 構成を Fig. 3 に示す。アンジュレータから生じる光はフロ ントエンドにある4象限スリット(図中A)を通り、発 散角を制限する。第一円筒鏡(図中M1)チャンバ、第二 円筒鏡(図中M2)チャンバ中の2枚のプラチナコートさ れた円筒鏡を用い垂直・水平方向の集光を行った。第一円 筒鏡はアンジュレータの中央から5,100 mm 下流に設置さ れ、入射角を86.0°とした。この鏡は前後15 mm 移動で き、直接アンジュレータ光を取り出すこともできる。第二 円筒鏡は第一円筒鏡より2,000 mm 下流に設置させ、入射 角を87.0°とした。この第二円筒鏡には3軸の調整機構が あり、光のスポットを STM 探針直下の試料表面上に移動



Fig. 2 Schematic drawing of BL7U. Main optical components are the in-vacuum undulator, the aperture stop (A), the first cylindrical mirror (M1) with a radius of 311.0 mm for vertical focusing, and the second cylindrical mirror (M2) with a radius of 59,700 mm for horizontal focusing. Both mirrors are Pt coated and the incident angles are 86° and 87°, respectively. The focal point (F) is located 9,100 mm downstream from the middle of the undulator.



Fig. 3 Photograph of BL7U.

させることができる。本ビームラインではエネルギー分解 能よりも高いフォトンフラックスを優先させるため分光器 は用いなかった

2.2 UHV-STM

BL7UのエンドステーションにはUNISOKU製STM 装置が設置されている。本装置は高温用STMであり SiO₂脱離観察(~700°C)をその場観察することができる。



Fig. 4 The top view of the internal construction of the UHV–STM chamber.

Fig. 4 に STM チャンバ内部の上面図を示す。チャンバ中 には STM ヘッドの他に試料の通電加熱が可能な試料準備 ホルダ (図中 sample preparation holder) があり、この試 料準備ホルダを用いて Si 表面の熱クリーニング及び水素 終端処理を行う。処理後の基板は STM ヘッドに移動さ れ、表面観察及びアンジュレータ光照射実験を行った。

試料周辺の拡大図を Fig. 4 右に示した。アンジュレータ 光は赤矢印に沿って導入され,STM 装置の側面の溝を通 過し試料表面に至る。アンジュレータ光照射後の表面をそ の場観察するため,STM 探針直下にアンジュレータ光を 位置調整する。試料への入射角は40°であり,試料表面で のスポットサイズは約1.3 mm×0.4 mm である。その際の フォトンフラックス密度は一次光のピークエネルギーを 100 eV とした場合約10¹⁸ photons cm⁻²sec⁻¹(リング電流 を200 mA,アンジュレータ光発散角を500 µrad とした) と見積もられる。

3. 水素吸着 Si(111)表面

UVSOR などの放射光施設での STM 観察は振動ノイズ などの影響により原子分解能が得られない可能性があるた め, BL7U の UHV-STM 装置を用いて Si(111)清浄表面 の観察を行った。

試料は12 mm×2 mm に切り出した B 添加 p 型 Si(111) 基板(抵抗率0.018 Ωcm)を用いた。試料を2×10⁻¹⁰ Torr の STM チャンバ中に導入し,試料準備ホルダで600 °C通電加熱した。12時間放置した後,1200°C 30秒のフラ ッシュアニーリングを行い,室温まで除冷した。その後, STM ヘッドに移動し,表面観察を行った。Fig. 5(a)に11 nm×11 nm STM 像を示した。STM 観察の測定条件は, 測定温度を室温,試料電圧-2.00 V,トンネル電流を0.25 -0.30 nA とした,以降の STM 観察においてもこの条件 を用いた。Fig. 5(a)では最表面の adatom 層が明瞭に観察 でき,放射光施設の中でも充分な原子分解能を持っている ことが分かる。

Fig. 5(b)にアンジュレータ光照射の初期表面として用いた水素終端 Si(111)表面の11 mm×11 nm STM 像を示



Fig. 5 $11 \text{ nm} \times 11 \text{ nm}$ STM images of (a) Si(111)-7×7, (b) H-Si (111) formed by H-exposure at 350°C.

す。水素終端 Si(111)表面は基板温度350°Cで10分間原子 状水素を供給することにより形成した。規則的に配列した 凸部を持つ表面上に原子が集合した島と点欠陥と思われる 明点(図中 small protrusion: SP)が観察される。この表 面構成は過去の報告¹³⁻¹⁵⁾と同様である。

規則配列した凸部を持つ表面は rest-atom が水素終端さ れた monohydride 表面であると考えられており,多くの 場所で7倍周期に近い構造を維持している。

Si(111)-7×7構造の最表面である adatom は原子状水 素供給下で Si_{adatom}-Si_{rest-atom} 結合が水素で次々に切断され, trihydride となり rest-atom monohydride 表面を移動する。 trihydride 同士は次第に集まり島を形成し再び安定化す る,このように adatom により生じた島が monohydride 表面で観察された島であると考えられている。この adatom 島の辺は 3 回対称の基板を反映し120°で交差してお り,高さは 2 原子層分の高さを持つ。また adatom 島の占 める面積は 1×1 表面の15-20%ML ほどであり,DAS 構 造で考えられる adatom の占める割合(18%)とほぼ等し い。

明点については、そのほとんどが rest-atom 直上(T1 サイト)に観察されるため、これらは孤立した trihydride または水素で終端されていない rest-atom と考えられ る¹⁵⁾。観察される明点密度は 1-2% ML であった。

4. 水素吸着 Si(111)表面へのアンジュレー タ光照射

Fig. 6(a)-(c)に水素吸着 Si(111)表面へのアンジュレー タ光照射を行った結果を示す。照射時のアンジュレータギ ャプは20 mm であり,このときの一次光ピークエネル ギーは約84 eV となる(**Fig. 1**参照)。光照射量としてリン グ電流と時間との積(mAsec)を用いた。

Fig. 6(a)はアンジュレータ照射前の表面であり, Fig. 5
(b)と同様な表面構造をとっている。この表面にアンジュレータ光5,000 mAsec 照射し, STM 観察を行った。Fig. 6
(b)にその STM 像を示す。明点数は大きく増加し,密度では1.4% ML から4.5% ML となった。さらに照射量を



Fig. 6 $10 \text{ nm} \times 10 \text{ nm}$ STM images of H–Si(111) surfaces after the undulator irradiations with the exposure of (a) 0 mAsec, (b) 5,000 mAsec and (c) 10,000 mAsec. The undulator gap height was fixed at 20 mm. It is observed that the SP density significantly increases with increasing irradiation dose. The appeared SPs are assigned to the rest-atoms with missing H.

10,000 mAsec まで増加させたところ(Fig. 6(c)), 明点密 度は増加し, 12.8%MLとなった。明点密度が光照射量に 伴って増加することから,水素脱離により rest-atom monohydrde から水素で終端されていない rest-atom にな ったと考えられる。このことはアンジュレータ光刺激によ り水素の脱離が促されることを示している。

照射光エネルギーに対する明点密度の変化を調べるため アンジュレータギャップを変化させ同様の実験を行った。 その際,照射量を5,000 mAsec と固定した。アンジュレー タギャップを17 mm, 20 mm, 25 mm と変化させた。その 時の一次光ピークエネルギーはそれぞれ68 eV, 84 eV, 113 eV となる Fig. 7(a)-(c)はそれぞれのアンジュレータ ギャップ値に対する6.8 nm×6.8 nm STM 像である。全て の STM 像で明点密度の増加が観察された。

ここで Si-H 分解に対する Si 2p 内殻電子励起の影響を 考察する。Si 2p 内殻電子励起しきい値は約100 eV にある ため、アンジュレータ照射後の明点密度と100 eV 以上の 光子に対するフラックス及び全フラックスとの関係を Table 1 に示した。38 nm×38 nm の STM 像から見積もっ た明点密度はアンジュレータギャップが17 nm の場合4.5 %,20 nm の場合4.5%,25 nm の場合3.8% ML であっ た。全フラックスはフラックスの計算値を0 eV から400 eV まで積分することによって得た。同様に100 eV 以上の 光子に対するフラックスは,フラックスの計算値を100 eV から400 eV まで積分することにより得た。用いたフラ ックスの計算値はリング電流を200 mA として計算した。 400 eV 以上のエネルギーに対するフラックスは5×10⁻¹⁴



Fig. 7 6.8 nm×6.8 nm STM images of H-Si(111) surfaces after the undulator beam irradiations with the undulator gap heights of (a) 17 mm, (b) 20 mm and (c) 25 mm. The irradiation dose was fixed at 5,000 mAsec.

Table 1 Undulator gap height dependence of the SP density

undulator gap height [mm]	SP density	photon flux above 100 eV [photons sec ⁻¹]	total photon flux [photons sec ⁻¹]
17	4.5	$1.7 imes 10^{16}$	$4.4 imes 10^{16}$
20	4.5	$1.0 imes 10^{16}$	$4.1 imes 10^{16}$
25	3.8	$2.5 imes 10^{16}$	$2.8 imes 10^{16}$

photons sec⁻¹以下となったため無視した。

仮に Si 2p 内殻電子励起が直接 Si-H 分解に寄与してい ると仮定すると,明点密度は100 eV 以上の光子に対する フラックスの増加に従い増加すると考えられる。しかしな がら観察結果は異なっている。よって Si 2p 内殻電子励起 過程は直接 Si-H 分解に直接関与していないことが明らか である。一方,価電子励起により水素脱離が生じていると 考えると,明点密度は全フラックス密度に依存することに なる。Table 1 では明点密度はアンジュレータギャップが 増加すると全フラックスが減少し,それに従い明点密度も 減少することが示される。

Si-H 分解に対する二次電子の寄与を見積もると分解した Si-H 結合全体の2%以下になると考えられる。アンジュレータギャップが25 mm の場合,試料から生じる光電流から見積もった二次電子のフラックスは 2.3×10^{14} electrons sec⁻¹ となる。このフラックスの値は入射する光密度の二桁小さい値となっている。二次電子の運動エネルギーは 2-5 eV と考えられ,このエネルギー領域に対する電子刺激水素脱離の断面積を 10^{-22} - 10^{-21} cm² と仮定すると16,17,水素原子の脱離数はおよそ 3.5×10^{9} - 3.5×10^{10}

cm⁻²sec⁻¹となる。ここで試料表面でのビームスポット 面積を5.2×10⁻³ cm²とし, rest-atom の密度を7.8×10¹⁴ cm⁻²として計算した。**Fig. 7(c)**での二次電子刺激水素脱 離に対応する明点数は0.4-0.04個となる。(**Table 1**中のア ンジュレータギャップ25 mm に対しては0.1%-0.01%ML となる。)

これらの結果から, rest-atom monohydride に対する主 な水素脱離機構は入射されるアンジュレータ光による価電 子の直接励起であると考えられる。Si 表面上への放射光 照射実験によると BML-IRRAS の結果 H-Si(100)-2×1 表面では Si-H 結合は放射光照射により分解されないこと が分かっている⁹⁾。一方, Takakuwa 等は H-Si(111)-1× 1 表面に置いて放射光照射により Si-H 分解を観測してい る¹⁸⁾。この結果より Si ダイマー結合が Si-H 価電子励起 状態に対して大きな影響があることが示唆される。

まとめ

アンジュレータ STM ビームラインを建設し,水素終端 Si(111)面へのアンジュレータ光照射実験を行った。アン ジュレータ光照射量の増加に伴い水素終端されていない rest-atom と考えられる明点密度が増加した。これはアン ジュレータ光照射により水素が脱離したことを示してい る。アンジュレータギャップを変化させ同様に照射を行っ たところ,表面の明点密度は Si 2p 内殻電子励起可能な 100 eV 以上の光子に対するフラックスではなく全フラッ クスに依存していることが分かった。この結果,水素終端 Si(111)表面からの水素脱離は入射アンジュレータ光によ る Si-H 価電子励起によるものだと考えられる。

謝辞

ビームラインの設計において貴重な議論をして頂きまし た分子研極端紫外光実験施設 加藤政博教授, 繁政英治助 教授に感謝いたします。ビームライン建設では分子科学研 究所装置開発室 松下幸司氏, 鈴井光一氏, 極端紫外光実 験施設 中村永研氏に多大なご協力いただきました,心よ り感謝いたします。また,本研究は科学研究費14750245, 13GS0016により援助を得て行われた。

参考文献

- T. Urisu and H. Kyuragi: J. Vac. Sci. Technol. B5, 1436 (1987).
- N. Hayasaka, A. Hiraya and K. Shobatake: Jpn. J. Appl. Phys. 26, L1110 (1987).
- T. Urisu, H. Kyuragi, Y. Utsumi, J. Takahashi and M. Kitamura: Rev. Sci. Instrum. 60, 2157 (1989).
- K. Shobatake, H. Ohashi, K. Fukui, A. Hiraya, N. Hayasaka, H. Okano, A. Yoshida and H. Kume: Appl. Phys. Lett. 56, 2189 (1990).
- Y. Sugita, Y. Nara, N. Nakayama and T. Ito: Jpn. J. Appl. Phys. 30, 3209 (1991).
- T. Miyamae, H. Uchida, I. H. Munro and T. Urisu: J. Vac. Sci. Technol. A17, 1733 (1999).
- M. L. Knotek, G. M. Loubriel, R. H. Stulen, C. E. Parks, B.
 E. Koel and Z. Hussain: Phys. Rev. B 26, 2292 (1982).
- H. Akazawa, M. Sugiyama, S. Maeyama, M. Oshima and Y. Watanabe: Phys. Rev. B 57, 4883 (1998).
- A. Yoshigoe, M. Nagasono, K. Mase and T. Urisu: Jpn. J. Appl. Phys. 34, 6894 (1995).
- H. Mekaru, Y. Tsusaka, T. Miyamae, T. Kinoshita, T. Urisu, S. Masui, E. Toyota and H. Takenaka: Rev. Sci. Instrum. 70, 2601 (1999).
- Y. Nonogaki, M. Katoh, E. Shigemasa, K. Matsushita, M. Suzui and T. Urisu: AIP Conf. Proc. 705, 368 (2004).
- 12) A. Mochihashi, M. Katoh, M. Hosaka, K. Hayashi, J. Yamazaki, Y. Takashima, Y. Hori, H. Kitamura, T. Hara and T. Tanaka: AIP Conf. Proc. 705, 259 (2004).
- K. Mortensen, D. M. Chen, P. J. Bedrossian, J. A. Golovchenko and F. Besenbacher: Phys. Rev. B 43, 1816 (1991).
- 14) J. J. Boland: Surf. Sci. 244, 1 (1991).
- 15) F. Owman and P. Martensson: Surf. Sci. 324, 211 (1995).
- 16) N. Matsunami, Y. Hasebe and N. Itoh: Surf. Sci. 192, 27 (1987).
- 17) M. M. Albert and N. H. Tolk: Phys. Rev. B 63, 035308 (2000).
- 18) Y. Takakuwa, M. Nogawa, H. Ishida, M. Niwano, H. Kato and N. Miyamoto: Jpn. J. Appl. Phys. 36, 7699 (1997).



STM observations for H desorption on H–Si(111) surfaces by using an undulator-STM beamline

Youichi NONOGAKI

Tsuneo URISU

Institute for Molecular Science/Graduate University for Advanced Studies, Myodaiji, Okazaki 444–8585, Japan Institute for Molecular Science/Graduate University for Advanced Studies, Myodaiji, Okazaki 444–8585, Japan

Abstract Undulator-STM beamline has been constructed at UVSOR BL7U for direct observation of irradiation effects on semiconductor surfaces. STM observation after undulator irradiation showed that density of small protrusions on the H–Si(111) surface increased with increasing irradiation dose. It indicates that the undulator irradiation stimulates H desorption from H–Si(111) surfaces. Si–H bond dissociation mechanism was also discussed with photon-energy dependence on density of the small protrusions.

放射光 Sept. 2005 Vol.18 No.5 ● 315